

2024越南国际集成电路及半导体产业展览会

产品名称	2024越南国际集成电路及半导体产业展览会
公司名称	广州汇连展览服务有限公司
价格	29000.00/个
规格参数	越南电子展:1 BQ:9 越南胡志明:500
公司地址	广州市天河区车陂祠堂大街2号全部（部位：236房）（注册地址）
联系电话	18680264099 18680264099

产品详情

SEMICON VIETNAM 2024

2024越南国际集成电路及半导体产业展览会

Vietnam Int'l Exhibition For Integrated Circuit And Semiconductor Industry

时间：2024年10月31日-11月02日

地点：越南胡志明SECC国际会展中心

产业转移浪潮对标越南全球性供应链

越南半导体及电路板发展商机衔接展

半导体供应链出海推广营销展贸平台

中越两国半导体及电路板外贸撮合汇

后十年越南电子业国家重点贸促活动

预设规模

150+参展商 · 250+展位 · 7000+观众 · 6+国家参展 · 10+越南交易团

为什么选择越南？

越南是世界贸易规模前20经济体,2023年GDP增幅5.05%位全球前列,预测未来几年增长率将达6.3-7.0% ;

越南已签署16个双边多边自由贸易协定,构建了高融合全球自贸区网络及低贸易壁垒供应链的新型经济体 ;

越南多年被评为全球具投资吸引力的新兴消费市场中30个经济体之一,全球电子企业纷纷将高技术生产环节转至越南,其成为全球电子产业链转移落脚点的“新宠”及制造中心之一,其电子产业市场总值约达1200亿美元 ;

2023年越南总进口额约3280亿美元,其中从中国进口约1116亿美元,中国仍是越南大进口市场 ;其中越南进口各类3C电子产品及零配件总值达882亿美元,其中从中国进口约为235亿美元 ;越南是全球电子消费增速快的5个国家之一,3C电子产品市场消费发展指数排在东盟十国的前列 ;

越南是12大电子产品出口国,95%出口额由外资企业掌控,越南市场上的电子产品多为进口整机或进口零部件在其国内组装,制品电子组件/材料/软件基本依赖进口 ;

越南半导体市场规模至2025年将增量约65亿美元,是亚洲地区半导体产业发展快的国家之一,其国家战略目标到2030年半导体芯片生产国产化率要达到50%,未来越南在全球半导体与集成电路价值链中将扮演不可估量的角色。

展会简介

目前中国供应链外迁越南风潮云涌,许多中国制造业以代工组装、换牌贴标等模式将工厂转移到越南,已有200多家上市公司在越南投资项目及上千家企业设立分支机构,并普遍采取“中国半成品/零配件 + 越南产业工人 + 越南产地证出口 + 越南本土市场垂直分销”等运作方式力促保持原有的全球供应链外贸份额。鉴于越南半导体与集成电路产业发展市场的成长性和爆发力,由越南政府支持主办的越南国际集成电路及半导体产业展览会(SEMICON VIETNAM)是衔接越南创新与科技发展战略国策的重要对外合作贸易项目,以“连接全球价值链,推动可持续电子产业发展”为主题,力邀美欧日韩、中国、东盟国家、印度等在电子领域拥有技术优势的国家参展,旨在为所有参展商在越南半导体与集成电路产业现代化发展进程蕴含的外贸商机及跨境投资、技术协作等方面提供的合作撮合机会,同期举办各项半导体与集成电路产业技术跨境贸易交流、B2B供需对接会、电子前沿科技技术推介、实地考察、优质技术产品评选等商务活动。本展会立足于越南电子制造业外贸中心基地,紧扣越南工业4.0发展国家战略推动力,专注于打造成为越南半导体与集成电路产业高新技术电子供应链定制与采购综合服务平台及产品、技术材料、元器件、生产设备等产业供应链全方位配套的供需商机高效衔接展会项目。

组织机构

支持指导：越南工贸部、越南科技部、越南胡志明市人民委员会

协办单位：越南胡志明市工贸厅、越南百科大学、越南光中软件园、韩国光学工业发展协会

主办单位：越南胡志明市工业配套促进中心、越南胡志明市高新技术开发区管委会

承办执行：越南电子与电路板半导体培训中心、越南全球展业股份公司

越南光线世界有限公司、越南骆驼会展贸促有限公司

中国承办：广州汇连展览服务有限公司

支持媒体

越南电视台、胡志明市电视台、越南工商论坛报、越南投资报、越南经济时报、越南电子自动化杂志、越南电子工艺杂志、越南电路板与电子系统杂志、越南电子技术杂志、越南baik大学电子计算机杂志、越南电子通讯技术杂志、越南主流网媒（VnExpress、24h、Thanh Nien、Vietnamnet、Dan Tri，Bao Moi...）及各社交媒介。

越南市场背景

目前越南已签署16个双边或多边的自由贸易协定,与全球主要经济体建立了广泛的自由贸易关系,构建了越南面向全球的自由贸易区网络,受贸易壁垒影响低,为其原产地产品出口提供了极高的市场增量空间,区域经济往来日趋密切。随着全球地缘政治及贸易格局的新变化,越南依靠人口红利的劳动力成本优势和外资投资优惠政策措施,通过其二十多年出口导向型经济模式获得较快经济发展所打下的基础,吸引了全球电子产业巨头纷纷赴越南建立先进技术的电子生产基地,高技术生产从中国转至越南的步伐加剧,令得越南快速成为亚洲地区电子代工制造中心之一及全球供应链转移落脚点的“新宠”,在全球电子产业链重构过程中处于崛起趋势。

现越南电子产业蓬勃发展的势头正盛,电子产品出口量由2001年的第47位跃升到2020年的第10位,美国和中国是越南电子产品的两大出口市场,一定程度上已对中国制造形成了出口替代;越南正成为全球电子手机制造基地,其手机出口量目前位列全球第二,全球制造出货量占比20%。由于越南本土工业基础较为薄弱及缺乏完整的供应链体系,尽管每年越南电子产品出口额超1000亿美元,但其电子组件和软件基本依赖进口,95%出口额由外资加工企业及其供应链附属供应商掌控。同时,越南作为全球具投资吸引力的新兴消费市场中30个经济体之一,其拥有年龄在18-60岁主力消费群体占总人口60%以上的超亿人口体量,对电子产品年需求近百亿美元,为业界外贸企业提供了增量市场广阔拓展空间。

越南连续颁布实施《到2030年第四次工业革命国家战略》、《至2030年创新与科技发展战略》等,将电子工业、信息及电信列入《越南工业发展战略(2030至2045年阶段)》重点优先投资发展产业之一,鼓励外国投资商在具备必要的基础设施和物质设施的电子工业集群、指定工业区中投资兴业,并力争到2030年成立10万家数字技术公司。《2021-2030年越南工业贸易结构调整提案》提出至2023年目标:工业配套产业要满足其国内需求的70%、产业本土化率要达到45%以上、高技术工业产品价值在加工制造业中的比重要达到45%以上,越南将成为现代工业国家,产业竞争力强以及跻身世界15大出口国行列。

越南的半导体市场在2020年至2025年间将增长16.5亿美元,年增长率为6.52%,期间其市场规模将增加约65亿美元,成为亚洲地区半导体产业发展快的地区之一。越南制定的《到2030年和远期到2045年越南半导体芯片产业发展战略》草案已进入审批阶段,旨在推动发展半导体产业乃至电子工业,并希望吸引全球半导体企业到越南生产与研发,目标到2030年半导体芯片生产国产化率要达到50%。目前越南仅有约5500名半导体领域工程师(其中胡志明市占比90%),仅能满足其产业配套技术人才的20%市场需求,现越南已开展跨国机构合作开展人力资源培养项目,以实现其到2030年培养5W名工程师的雄心勃勃的目标。目前越南芯片制造商尽管仍依赖从其他国家进口材料,但其拥有硅砂、稀土等丰富的自然资源和原材料(越南稀土储量约有2200万吨位列全球第二),并设立了国家技术创新基金等融资基金机构支持半导体产业的发展。截止到2023年底,全球各国已承诺在越南半导体领域投资约50亿美元。

举办城市-胡志明市

越南南部地区的胡志明市及其周边省份区域,经过十多年的电子产品发展历程,在产品研发、生产、组装、代工出口、外贸基地、物流等上下游产业链积聚了较强的产业基础,集中了越南全国52%以上的电子生产组装产能企业及85%集成电路&半导体研发人才,业已成为越南全国电子工业制造中心、消费大区及城市。

展出范围

* 半导体材料:硅片及硅基材料、硅晶圆、硅晶片、单晶硅、硅片、锗硅材料、S01材料、太阳能电池用硅材料及化合物半导体材料、石英制品、石墨制品、防静电材料、光刻胶及其配套试剂、晶圆胶带、光

掩膜版、电子气体、特种化学气体、CMP抛光材料、封装基板、引线框架、键合丝、包封材料、陶瓷基板、封测材料等。

* 晶圆制造及封装：晶圆制造、SiP封装、硅晶圆及IC封装载板、印制电路板、封装基板和设备及组装和测试等、封装设计、测试、设备与应用制造与封测、EDA、MCU、印制电路板、封装基板半导体材料与设备等。

* 集成电路制造技术：晶圆制造/代工、模拟集成电路、数/模混合集成电路；相关微处理器、存储器、FPGA、分立器件、光电器件、功率器件、传感器件等技术器件；集成电路终端产品。

* 半导体设备制造：封装设备、扩散设备、焊接设备、清洗设备、测试设备、制冷设备、氧化设备、贴片机、单晶炉、氧化炉、研磨机、光刻机、刻蚀机、抛光机、离子注入设备、CVD/PVD设备、涂胶/显影机、回流焊、波峰焊、探针台、洁净室设备等。

* 封装与测试配套：测试探针台、探针卡、测试机、分选机、封装设备、封装基板、引线框架键合丝、引线键合、烧焊测试、激光切割、研磨液、封片膜(胶)高温胶带、层压基板、贴片胶、上料板、焊线流量控制、石英石墨、碳化硅等。

* 第三代半导体：第三代半导体碳化硅SiC、氮化镓GaN、晶圆、衬底、封装、测试、光电子器件(发光二极管LED、激光器LD、探测器紫外)、电力电子器件(二极管、MOSFET、JFET、BJT、IGBT、GTO、ETO、SBD、HEMT等)、微波射频器件(HEMT、MMIC)等。

* 智慧电源技术：微波射频、半导体LED、离子电源、共享智慧充电、通信电源、光伏/风电/储能电源设计、功率变换器磁技术等。

* IC设计：IC及相关电子产品设计、IC产品与应用技术、IC测试方法与测试仪器、IC设计与设计工具、IC制造与封装、EDA、IP设计、嵌入式软件、数字电路设计、模拟与混合信号电路设计、集成电路布局设计等。

* 电子元器件：电阻、电容器、电位器、电子管、散热器、机电元件、连接器、半导体分立器件/IGBT、电声器件、激光器件、电子显示器件、光电器件、传感器、电源、开关、微特电机、电子变压器、继电器、印制电路板、印刷电路用基材基板、无源器件、5G核心元器件、元电源管理、储存器、PCB板、电机风扇、电声器件、显示器件、二极管、三极管等。

* 前沿创新应用：AI芯片、显示芯片、驱动芯片、电源管理芯片、电器芯片、传感器芯片、物联网芯片、通信芯片、交通电子芯片、计算机及控制芯片、存储器芯片、5G芯片、车规级芯片、音视频处理芯片等。

* 双向合作项目：该领域新技术/新产品科研成果、研发与设计、项目投资、技术转让、OEM/ODM代工、联营产销、代理经销、品牌连锁加盟、检测技术服务等合作。